

SOLDER FORTIFICATION® 预成型焊片

SOLDER FORTIFICATION® 解决方案

标准尺寸 (其他尺寸可应求提供):

名称	尺寸	每卷数量		参考重量: SAC305 (grams/片)
		7"	13"	
0201	0.254mm x 0.508mm x 0.254mm (0.010" x 0.020" x 0.010" 长方形)	1k	50k	0.00024
0402	0.508mm x 1.01mm x 0.48mm (0.020" x 0.040" x 0.019" 长方形)	1k	15k	0.00182
0603	0.76mm x 1.52mm x 0.787mm (0.030" x 0.060" x 0.030" 长方形)	1k	15k	0.00672
0805	1.27mm x 2.03mm x 1.27mm (0.050" x 0.080" x 0.050" 长方形)	1k	15k	0.02410

包装

Solder Fortification® 预成型焊片的卷带包装可用标准的贴片轻放置。

常见合金

- SAC305
- SAC387
- Sn63
- Sn62
- BiSn
- BiSnAg

技术支持及客户服务

钢泰公司拥有经验丰富的国际工程师,可为我们的客户提供深度技术协助。

技术支持工程师深谙电子和半导体领域中材料科学应用的各个方面,能为焊料属性、合金兼容性和预成型焊片、焊锡线、焊带和焊锡膏的选择提供专家级建议。钢泰公司的技术支持工程师竭诚为您服务,将第一时间回应所有技术咨询。



SOLDER FORTIFICATION® 预成型焊片 设计指南



联络我们: china@indium.com

详情请访问: www.indiumchina.cn

From One Engineer To Another®

©2017 钢泰公司

表格编号: 99350 (SC A4) R0



SOLDER FORTIFICATION® 预成型焊片

简介

在电子制造中，正确的焊料量对保证焊点的强度至关重要。然而，微型化趋势（如钢网厚度减小和元件排列更紧凑）使其变得更加困难。**Solder Fortification® 预成型焊片**能为这些极具挑战性的问题提供解决方案。

Solder Fortification® 预成型焊片一般为不含助焊剂的长方形或者圆环状的合金片。这种预成型焊片通过标准的贴片机放在已沉积的焊锡膏上。因为预成型焊片和焊锡膏的合金相同，这种预成型焊片的回流温度和焊锡膏一致，而在这个过程中，焊锡膏会提供必要的助焊剂。这种预成型焊片可在焊锡膏极限上增加焊料量，这对间距等于或小于0.3毫米的钢网非常重要。

特点

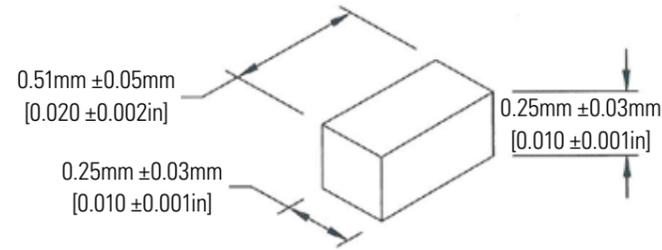
- 增加焊料量
- 提高跌落测试结果
- 助焊剂残留物的问题更少
- 减少返修
- 增强焊点的形状和量
- 能将贴片速度提到最高

优点

Solder Fortification® 预成型焊片的优点包括：

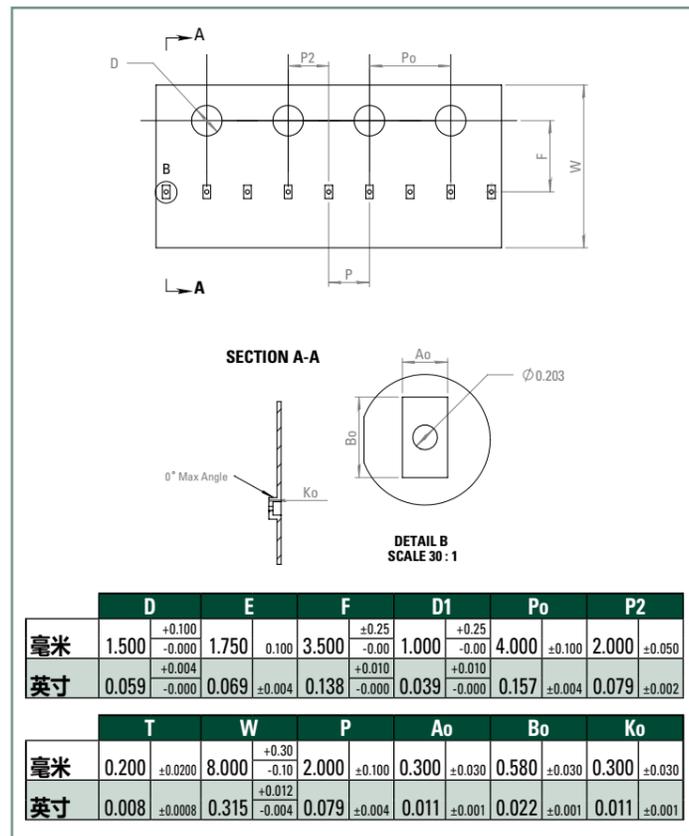
- 在焊锡膏极限上，增加焊料量
- 助焊剂残留物问题更少
- 消除昂贵或者耗时的工艺，如波峰焊和选择焊
- 更强的焊点可以帮助提高跌落测试结果
- 减少用于增加焊料量的返修和其他手工流程
- 焊点的形状和量增强，从而保证焊点满足IPC的要求

可焊的预成型焊片 0201

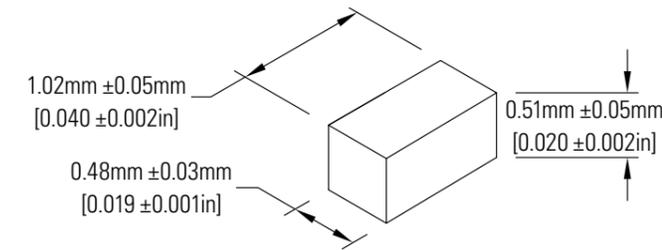


注：除非额外标出

标准材料， 其他合金可应求提供	SAC305 Sn62 Sn63
每卷50k (13"的卷带)	
13"的卷带包装的中心轴为2.5"	

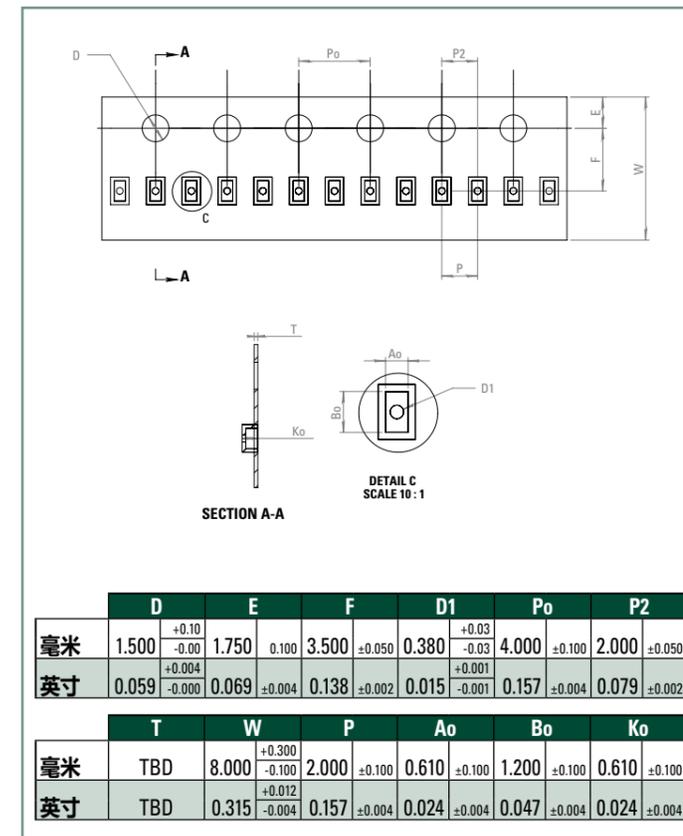


可焊的预成型焊片 0402

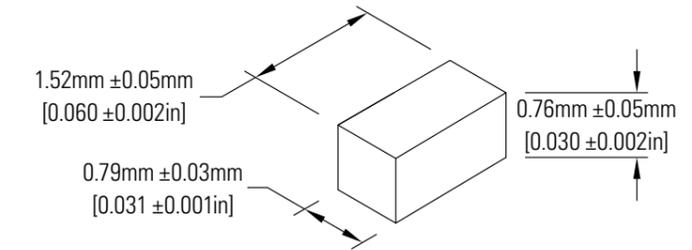


注：除非额外标出

标准材料， 其他合金可应求提供	SAC305 SAC387 Sn62 Sn63
每卷50k (13"的卷带)	
13"的卷带包装的中心轴为2.5"	



可焊的预成型焊片 0603



注：除非额外标出

标准材料， 其他合金可应求提供	SAC305 SAC387 Sn62 Sn63
每卷50k (13"的卷带)	
13"的卷带包装的中心轴为2.5"	

